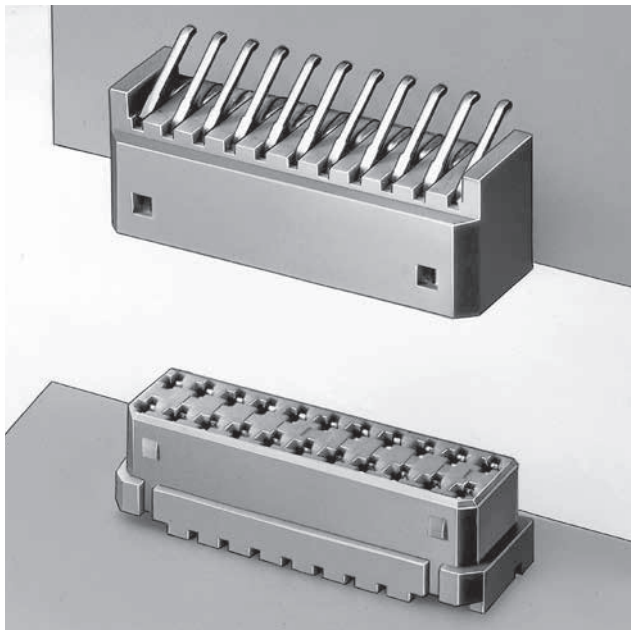


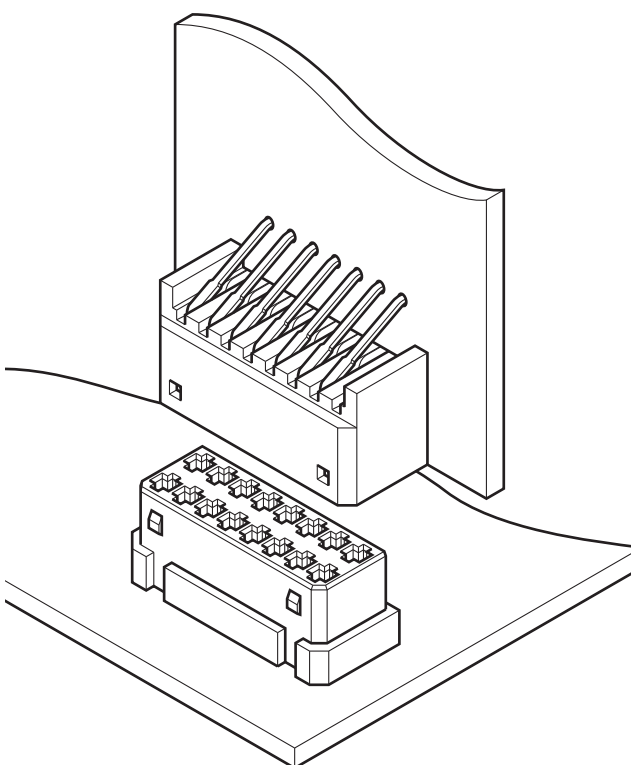
1.25mmピッチ

# JED CONNECTOR

プリント基板用コネクタ／基板対基板用



1.25mmピッチ二列構造を採用した基板対基板接続用コネクタです。実装高さ7.0mm(トップ型)、厚さ4.6mmの小型設計。高接触圧両面接触の接続部と確実なロック構造により安定した接続信頼性を発揮します。



## ■特長

- ニーズに応えた小型設計  
嵌合部およびはんだ付け部共に1.25mmピッチ二列構造を採用。実装高さ7.0mm(トップ型)、厚さ4.6mmと小型設計です。
- 確実なロック構造、高信頼接続  
接触部に高接触圧両面接触のフォーク型コンタクト採用をはじめ、確実なハウジングロック構造により、機器の振動や衝撃に対しても安定した接続信頼性を発揮します。
- ボックス型ハウジング  
嵌合時の誤挿入、こじり挿抜を防止するボックス型ハウジングを使用。プラグおよびリセプタクルとの嵌合をリジットにし、振動に対する耐久性向上に効果を発揮します。

## ■一般仕様

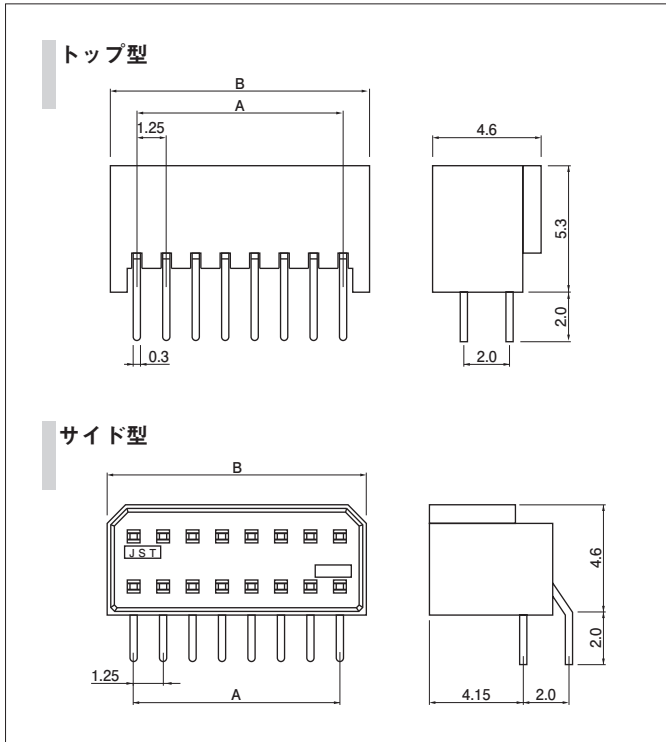
- 定格電流：1.0A AC・DC
  - 定格電圧：50V AC・DC
  - 使用温度範囲：-25℃～+85℃(通電時の温度上昇値を含む)
  - 接触抵抗：初期／20mΩ以下  
環境試験後／40mΩ以下
  - 絶縁抵抗：300MΩ以上
  - 耐電圧：AC 500V・1分間
  - 適合プリント基板厚さ：0.8mm～1.0mm
- ※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。  
※詳細は弊社までお問い合わせください。  
※RoHS対応品を掲載しています。

## ■登録規格

海外規格登録については、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術資料)に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。  
※海外規格に登録の仕様は、上記の一般仕様と異なる場合があります。

# JED CONNECTOR

## プラグ



極数	形番		寸法 (mm)		個数/箱	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
8	08P-JED	08PS-JED	3.75	5.95	500	500
16	16P-JED	16PS-JED	8.75	10.95	500	500
22	22P-JED	22PS-JED	12.50	14.70	500	500

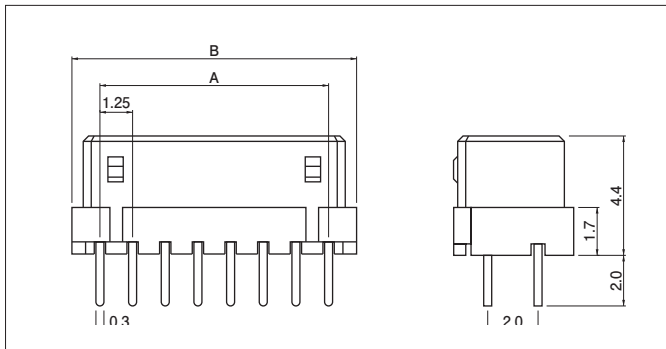
### 材質・表面処理

コンタクト：黄銅・すずめっき (リフロー処理)  
ハウジング：ガラス入ナイロン66

### ●RoHS 対応品

注) 使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料) に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

## リセプタクル



極数	形番	寸法 (mm)		個数/箱
		A	B	
8	08R-JED	3.75	5.95	500
16	16R-JED	8.75	10.95	500
22	22R-JED	12.50	14.70	500

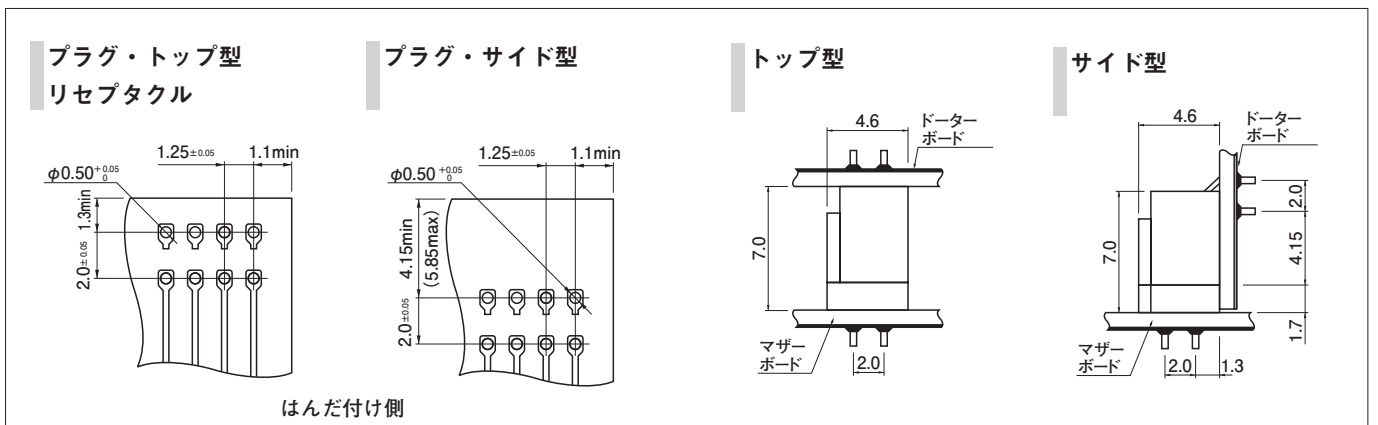
### 材質・表面処理

コンタクト：りん青銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)  
ハウジング：ガラス入ナイロン66

### ●RoHS 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

注) 使用樹脂材料の難燃グレードは、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料) に掲載の「海外規格登録状況一覧」を参照ください。

## 基板レイアウト・組立レイアウト



- 注 1) 基板の穴あけは全体にわたって公差 ± 0.05 で累積しないこと。  
注 2) 基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。  
上記記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

注) ドーターボードの固定が必要です。固定方法の詳細については弊社までお問い合わせください。